

第3回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成25年 9月 11日(水) 10:30~16:15

場所:大阪大学 吹田キャンパス 岡田メモリアルホール(大阪府吹田市)

時間	題目	講演者
	司会 井上 雅博(群馬大学)	
10:30~ 12:10	『高電力密度パワーモジュールの開発と 回路実装』 (60分)	大阪大学 ○ 舟木 剛
	『高熱伝導有機材料の パワーモジュールへの応用』 (40分)	三菱電機(株) ○ 多田 和弘
12:10~ 13:10	昼食休憩	
13:10~ 13:15	委員会議事	
	司会 出田 吾朗(三菱電機(株))	
13:15~ 14:25	『ナノコンポジットによるエポキシ樹脂の 高耐熱化』 (40分)	富士電機(株) ○ 竹松 裕司
	樹脂実装研究会活動報告 『アンダーフィル材の引張特性に及ぼす フィラー添加量および熱劣化の影響』 (30分)	群馬大学 ○ 三ツ木 寛尚, 北郷 慎也, 荘司 郁夫, 小山 真司
	休憩(20分)	
	司会 荘司 郁夫(群馬大学)	
14:45~ 16:15	樹脂実装研究会活動報告 『樹脂実装電子デバイスにおける応力緩和』 (30分)	大阪大学 ○ 松嶋 道也
	樹脂実装研究会活動報告 『導電性接着剤の熱伝導率評価』 (30分)	(株)東レリサーチセンター ○ 平野 孝行, 大阪大学 西川 宏
	樹脂実装研究会活動報告 『導電性接着剤の機能発現挙動解明を 目的とするキュアプロセス解析』 (30分)	群馬大学 ○ 井上 雅博, 大阪大学 小日向 茂, 上西 啓介

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。